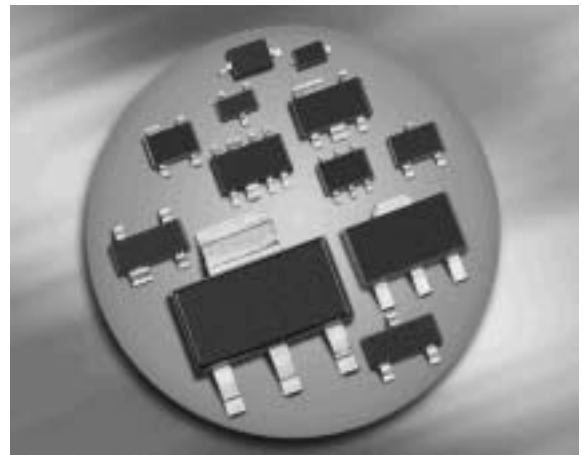
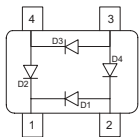


Silicon Switching Diode Array

- Bridge configuration
- High-speed switching diode chip
- Pb-free (RoHS compliant) package ¹⁾
- Qualified according AEC Q101


BGX50A


Type	Package	Configuration	Marking
BGX50A	SOT143	bridge	U1s

Maximum Ratings at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Value	Unit
Diode reverse voltage	V_R	50	V
Peak reverse voltage	V_{RM}	70	
Forward current	I_F	140	mA
Non-repetitive peak surge forward current	I_{FSM}	-	
Total power dissipation $T_S \leq 74^\circ\text{C}$	P_{tot}	210	mW
Junction temperature	T_j	150	°C
Storage temperature	T_{stg}	-65 ... 150	

Thermal Resistance

Parameter	Symbol	Value	Unit
Junction - soldering point ²⁾ BGX50A	R_{thJS}	360	K/W

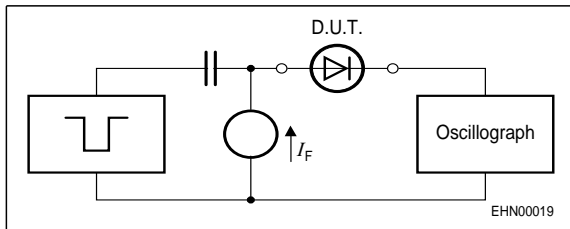
¹Pb-containing package may be available upon special request

²For calculation of R_{thJA} please refer to Application Note Thermal Resistance

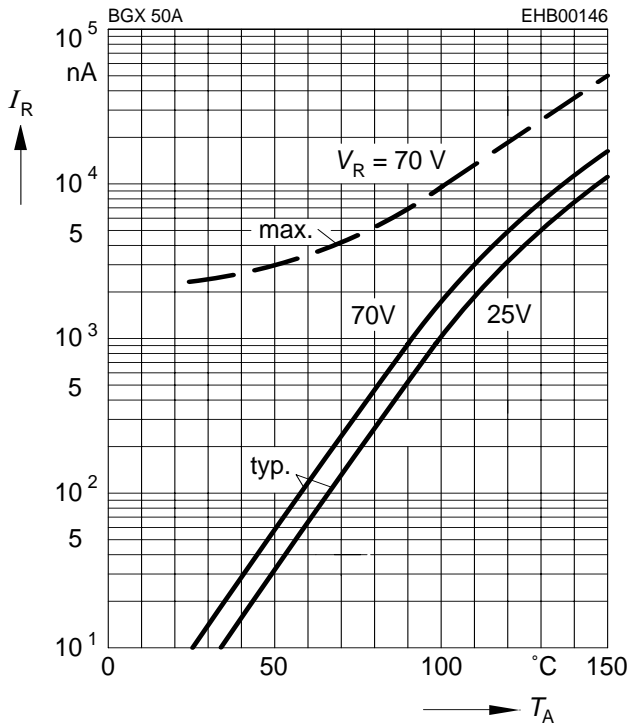
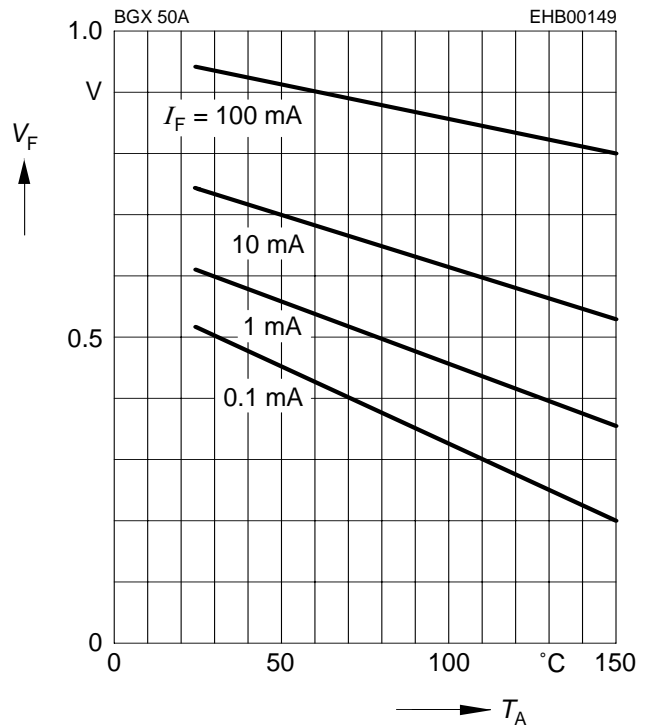
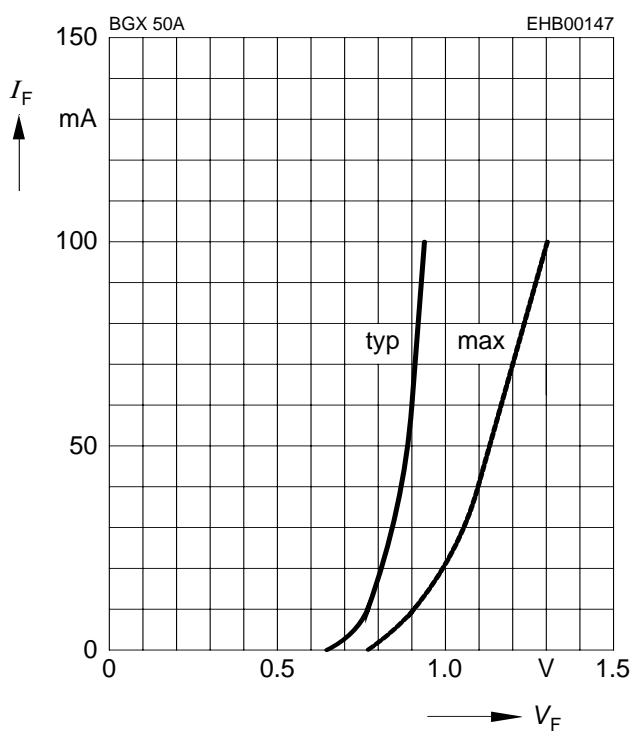
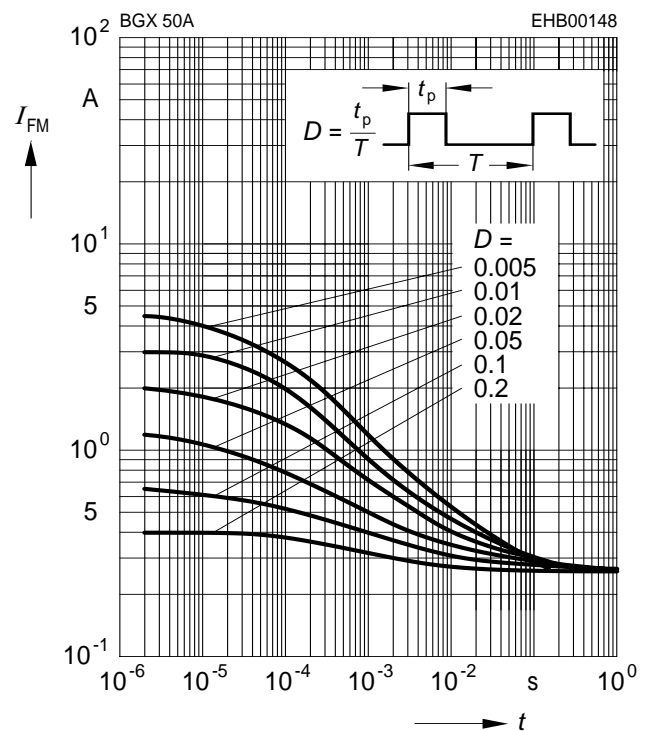
Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
DC Characteristics					
Breakdown voltage	$V_{(BR)}$	-	-	-	
Reverse current	I_R				μA
$V_R = 50\text{ V}$		-	-	0.2	
$V_R = 50\text{ V}, T_A = 150^\circ\text{C}$		-	-	100	
Forward voltage	V_F	-	-	1.3	V
$I_F = 100\text{ mA}$					

AC Characteristics					
Diode capacitance	C_T	-	-	1.5	μF
$V_R = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$					
Reverse recovery time	t_{rr}	-	-	6	ns
$I_F = 10\text{ mA}, I_R = 10\text{ mA}$, measured at $I_R = 1\text{ mA}$, $R_L = 100\ \Omega$					

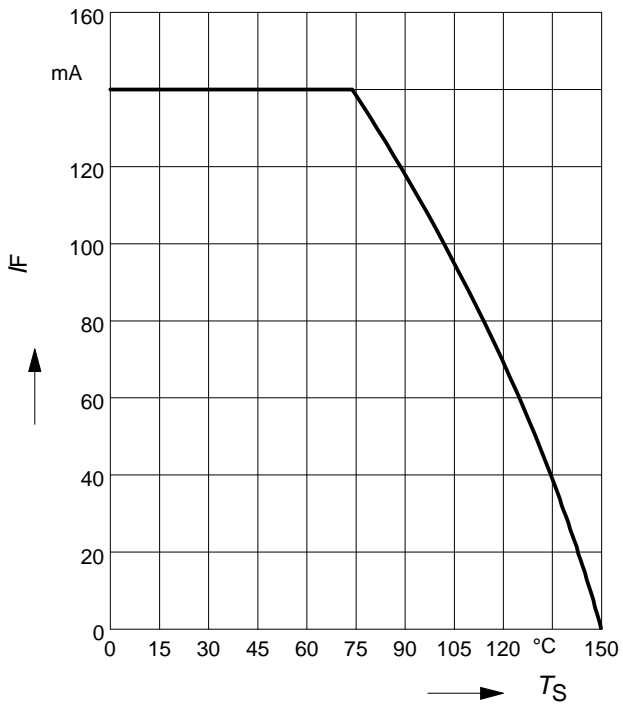
Test circuit for reverse recovery time

 Pulse generator: $t_p = 100\text{ ns}$, $D = 0.05$, $t_r = 0.6\text{ ns}$,
 $R_i = 50\ \Omega$

 Oscilloscope: $R = 50\ \Omega$, $t_r = 0.35\text{ ns}$, $C \leq 1\text{ pF}$

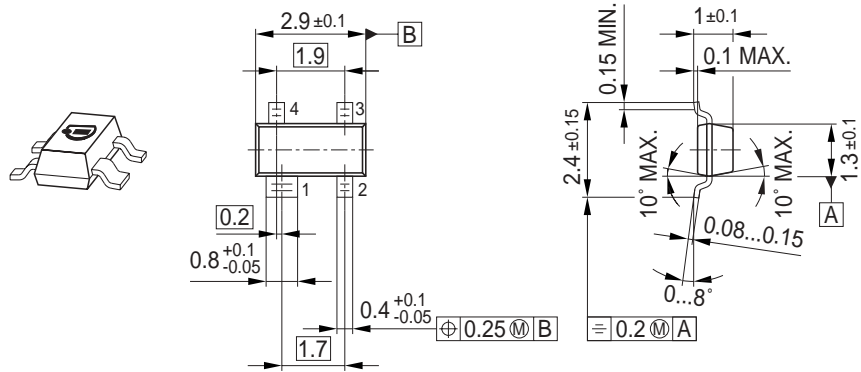
Reverse current $I_R = f(T_A)$
 $V_R = \text{Parameter}$

Forward Voltage $V_F = f(T_A)$
 $I_F = \text{Parameter}$

Forward current $I_F = f(V_F)$
 $T_A = 25^\circ\text{C}$

Peak forward current $I_{FM} = f(t_p)$
 $T_A = 25^\circ\text{C}$


Forward current $I_F = f(T_S)$

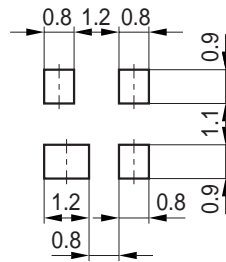
BGX50A



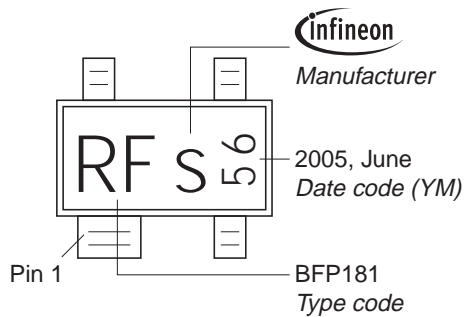
Package Outline



Foot Print

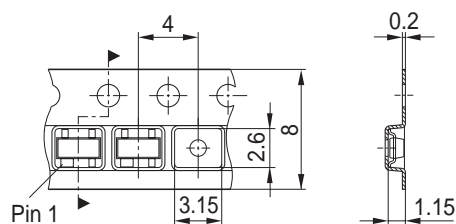


Marking Layout (Example)



Standard Packing

Reel $\varnothing 180 \text{ mm} = 3.000 \text{ Pieces/Reel}$
 Reel $\varnothing 330 \text{ mm} = 10.000 \text{ Pieces/Reel}$



Edition 2006-02-01

Published by

Infineon Technologies AG

81726 München, Germany

© Infineon Technologies AG 2007.

All Rights Reserved.

Attention please!

The information given in this dokument shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics ("Beschaffenheitsgarantie"). With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies Office (www.infineon.com).

Warnings

Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies Components may only be used in life-support devices or systems with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect the safety or effectiveness of that device or system.

Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body, or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.